

目录

特性参数.....	2
亮度分档.....	2
显指分档.....	2
电压分档.....	2
色区分档.....	3
光电性能特征曲线...	4、5
出货编码规则.....	6
产品尺寸.....	6
包装规格.....	7、8
回流焊曲线.....	9
注意事项.....	10

产品特征

规格: 5.0 mm×5.0mm
垂直结构陶瓷封装
典型光通量 (25℃)
700mA: 275lm

应用

高端商照
汽车照明
电摩大灯

特性参数 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees (°)	--	120	--
直流正向电流	mA	--	700	1500
反向电压	V	--	--	5
正向电压(700mA,25°C)	V	--	3.1	--
LED 结温	°C	--	--	125

亮度分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

分档	亮度范围 (lm)
T3	220~240
T4	240~260
T5	260~280
T6	280~300

备注：亮度测试误差±7%

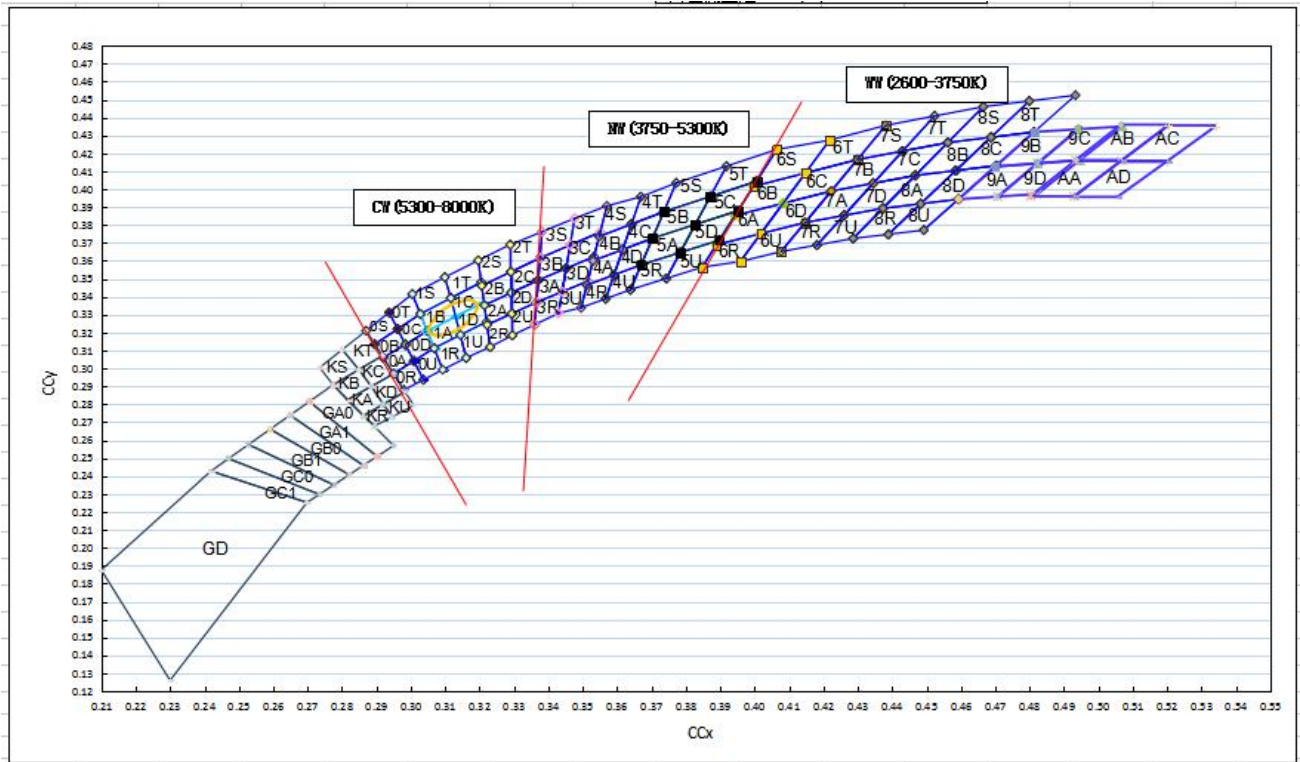
显指分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

级别	范围
B0	67~100

电压分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

级别	电压范围 (V)
V2	3.0~3.2
V3	3.2~3.4

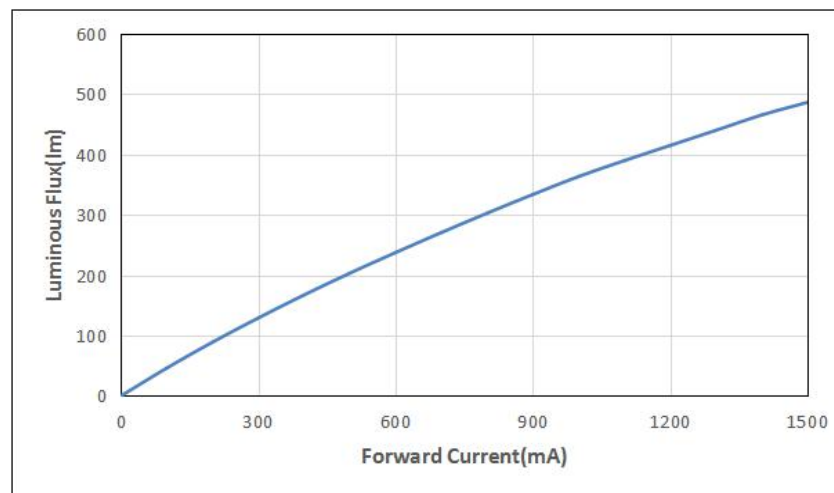
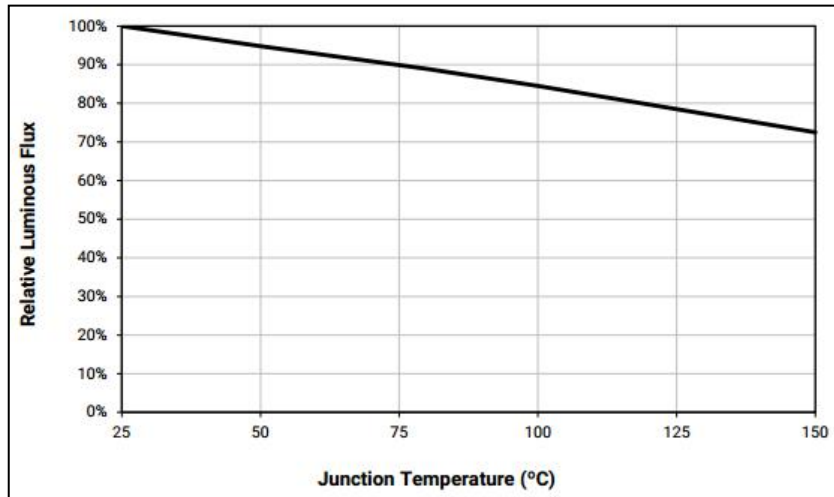
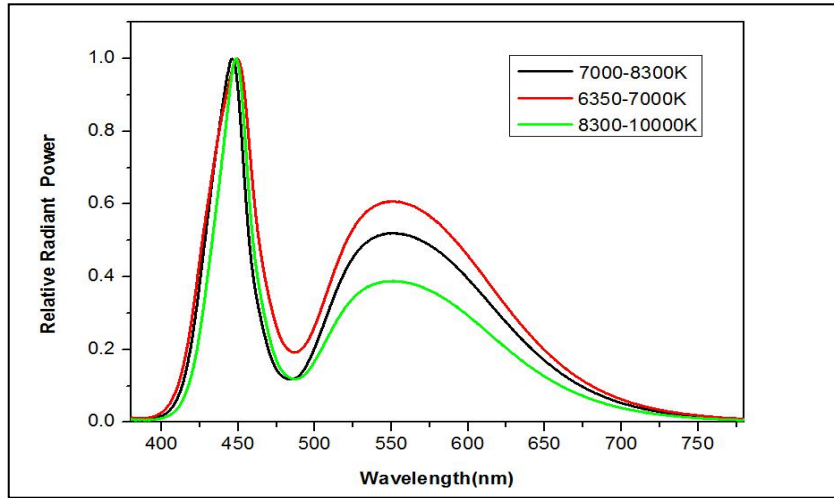
色区分档 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)

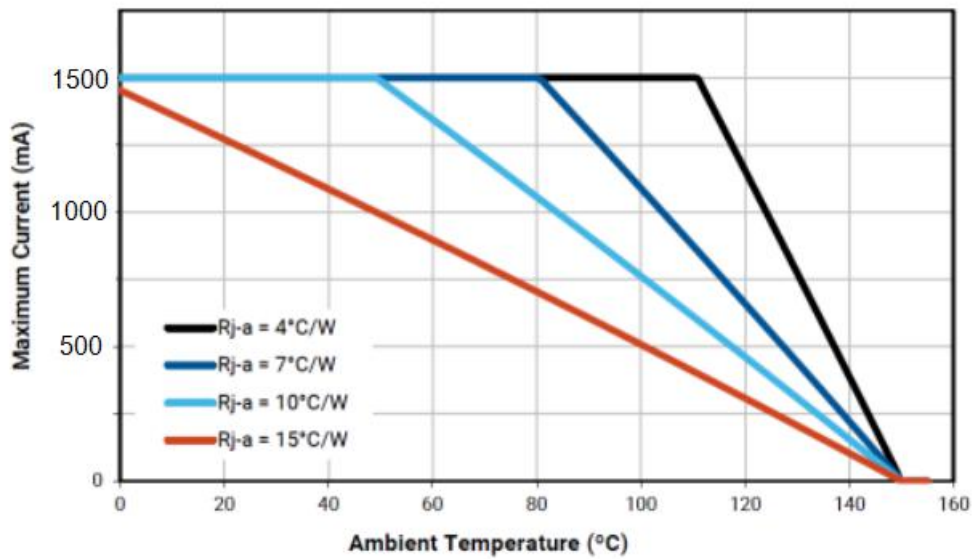
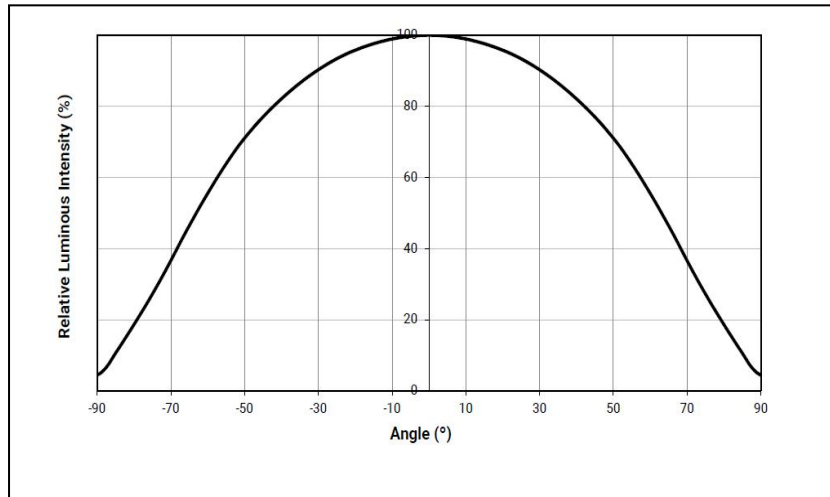
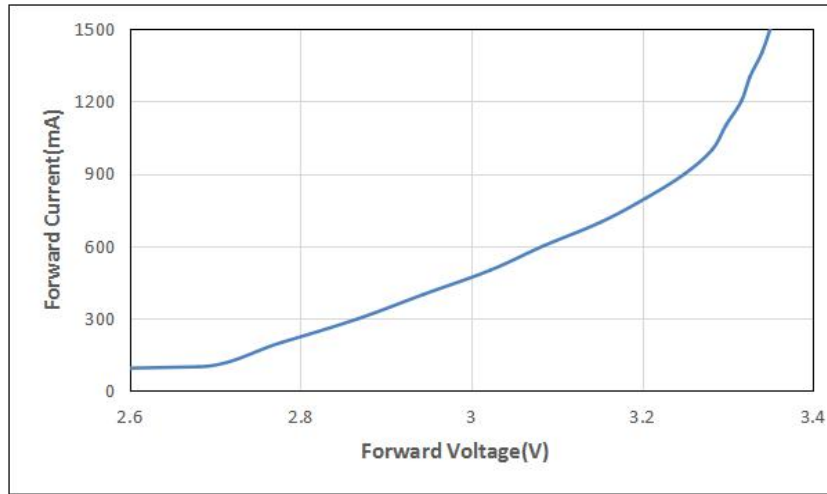


备注：色坐标误差 ± 0.0050

色度 & 色温对照表	
典型色温 (K)	色度区域
5300~5700	2T、2C、2D、2U
5700~6000	2S、2B、2A、2R
6000~6500	1T、1C、1D、1U
6500~7000	1S、1A、1B、1R
7000~8200	0A、0B、0C、0D、0R、0S、0T、0U
8200~9000	KC、KD、KT、KU
9000~10000	KA、KB、KR、KS
10000~11500	GA0
11500~13000	GA1
13000~15000	GB0
15000~18000	GB1
18000~22000	GC0
22000~27000	GC1

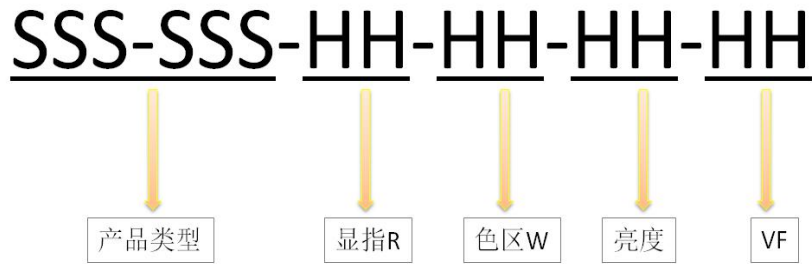
光电性能特征曲线 ($I_F = 700 \text{ mA}$, $T_{\text{solder pad}} = 25^\circ\text{C}$)





出货条码规则

下图为产品编码规则

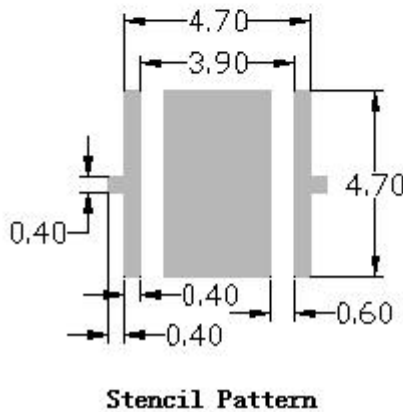
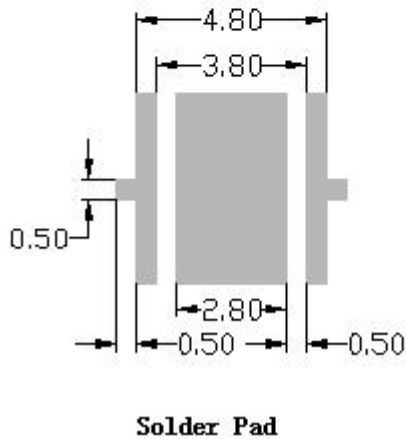
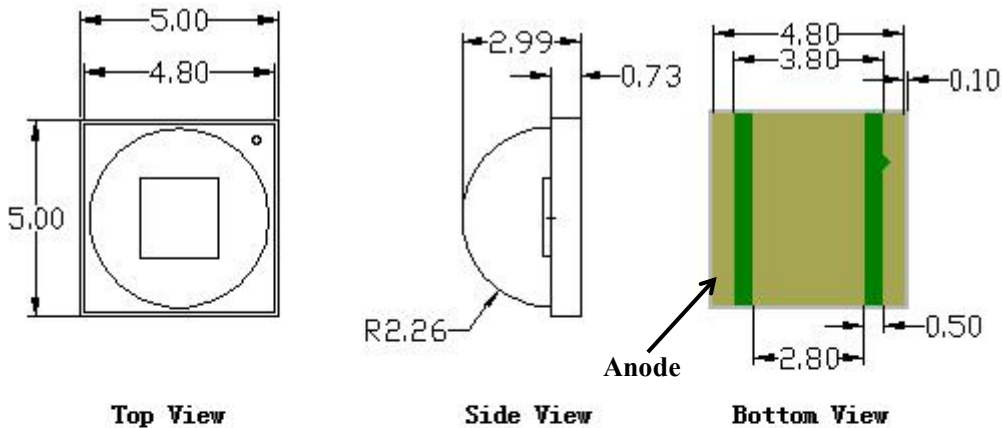


例如：LMK1AW-B0-0A-T4-V2，其中 AW 表示白光；B0 表示显指，对应范围 67-100；0A 表示色区，对应范围 7000~8200K；T4 表示亮度，对应范围 240-260lm；V2 表示正向电压 3.0-3.2V。

产品尺寸

单位：mm.

误差：±0.05

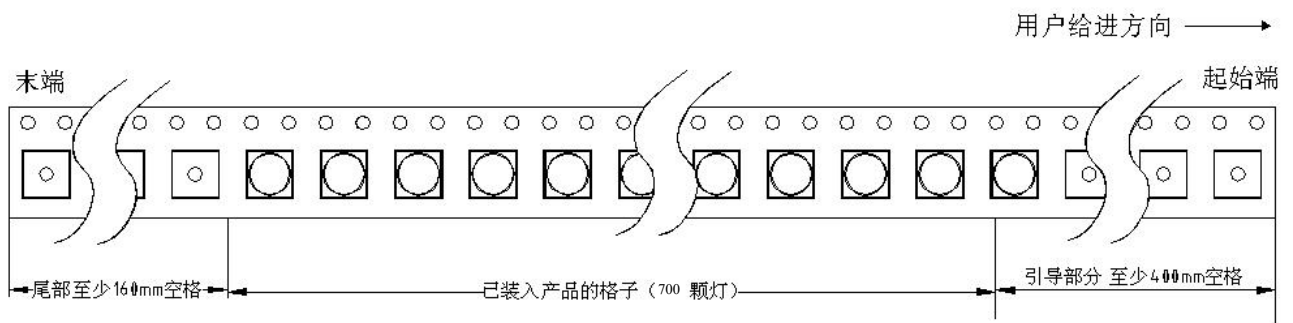
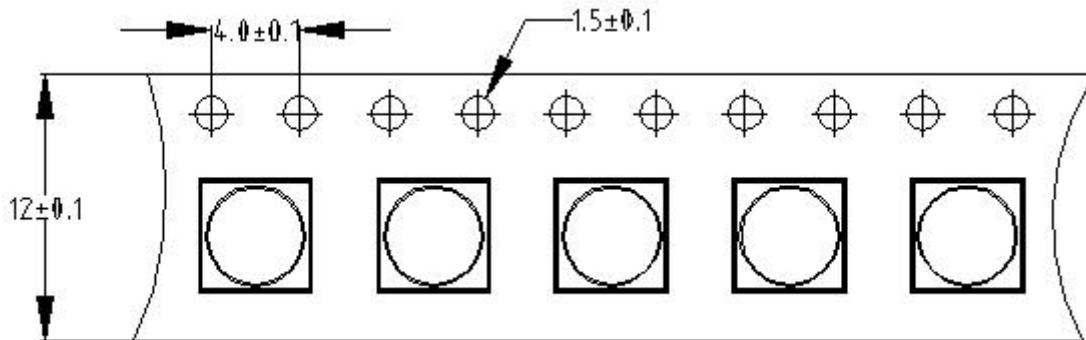


包装规格

包装方式：7 英寸卷盘包装 (包装数量：700pcs)

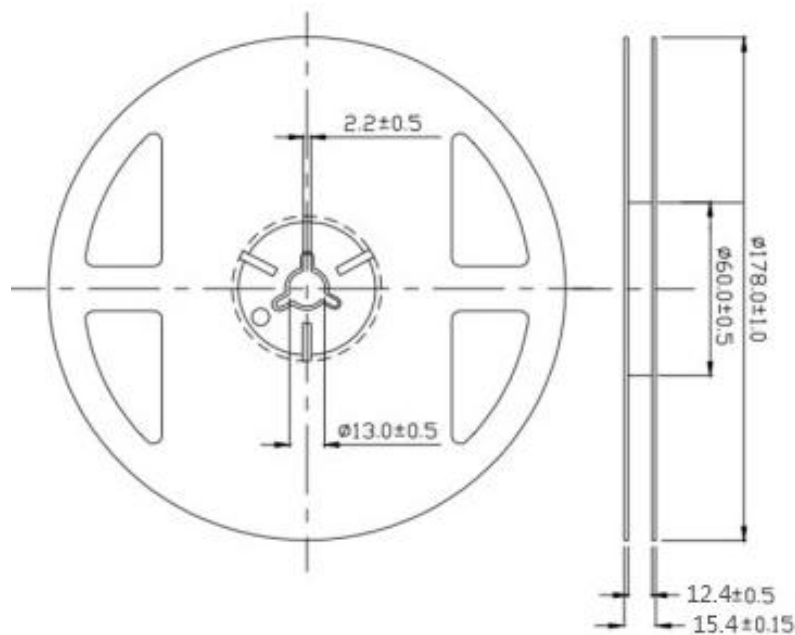
单位：mm

载带尺寸图

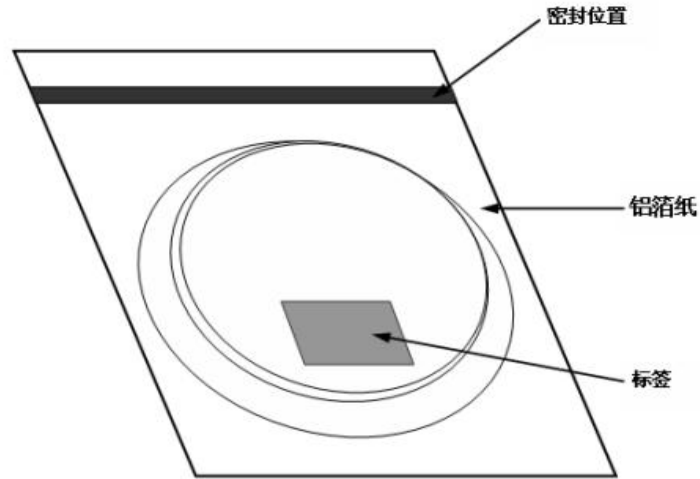


卷盘尺寸图

单位：mm



防潮包装



出货条码

北大青鸟
BEIDA JADE BIRD
LMP
中国陶瓷封装标杆企业

CE ROHS

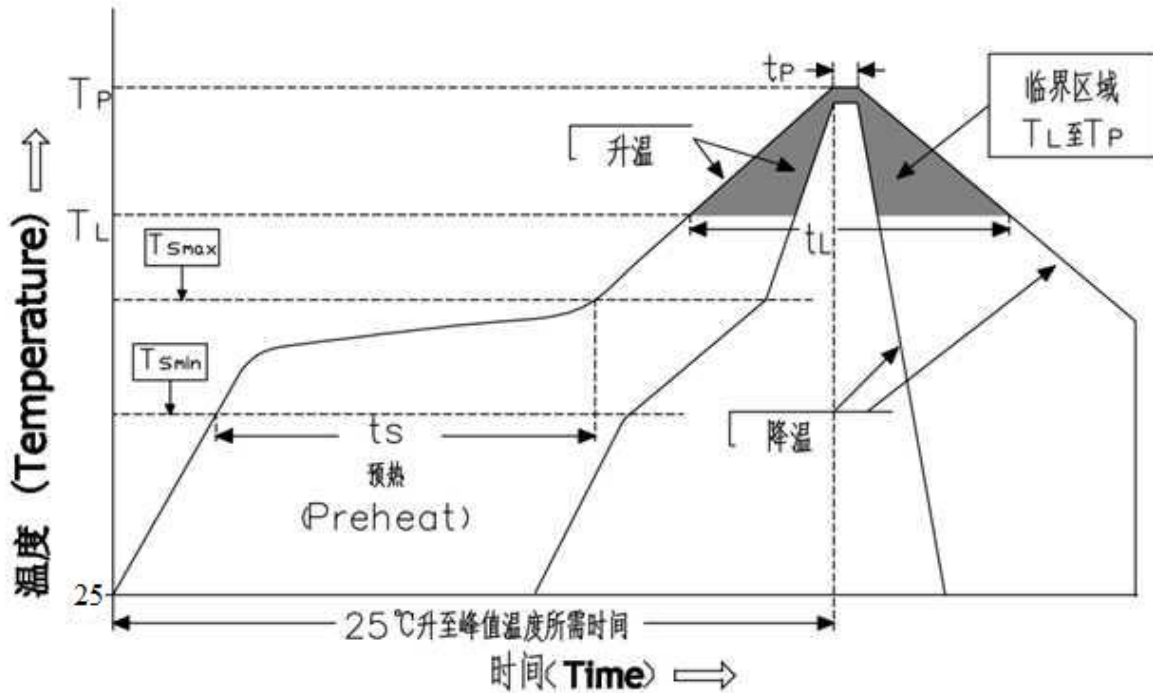
Seal Date: 13-0cT-2016

Item: LMK1AW-B0-0A-T4-V2

Qty: 700 Reel ID ALMK1AW00002033



回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度 ($T_{Smax}-T_p$)	3°C/second max.	3°C/second max.
最低预热温度 (T_{Smin})	100°C	150°C
最高预热温度 (T_{Smax})	150°C	200°C
预热时间 ($t_{Smin}-t_{Smax}$)	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 (T_L)	183°C	217°C
维持在 T_L 以上的时间 (t_L)	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度 (T_p)	215°C	260°C
维持与实际峰值温度相差在 5°C 以内的时间 (t_p)	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25°C 升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

备注:

1. 所有温度指封装表面温度，为封装体表面测定的数据；
2. 本回流焊曲线提供参考，并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备；
3. 其他事项请参考《使用注意事项》。

使用注意事项

一、储存

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

二、使用

1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260℃,时间小于 10s。
3. 重复回流焊不超过 2 次。
4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。